

SL-SMT 5.08HC/02/90G 3.2SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, Tape
注文番号	1884210000
種別	SL-SMT 5.08HC/02/90G 3.2SN BK RL
GTIN (EAN)	4032248488438
数量	350 Stück
製品データ	IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A
パッケージ	Tape

作成日 2024/11/05 19:20:07 CET

SL-SMT 5.08HC/02/90G 3.2SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.472 inch
高さ	11.6 mm	高さ (インチ)	0.457 inch
下位バージョンの高さ	8.4 mm	幅	12.06 mm
幅 (インチ)	0.475 inch	正味重量	1.92 g

システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.2 "	外向きエルボ	90°
極数	2	極当たりソルダーピン数	1
ソルダーピン長 (l)	3.2 mm	ソルダーピン長 公差	0 / -0.3 mm
はんだピン寸法	d = 1.2 mm, 八角形	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.4 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	5.08 mm
L1 (インチ)	0.2 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガーセーフプラグ抜き/バックオブハンドセーフのプラグ差込
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続/IP10接続解除	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
差し込み力 / 極、最大	9 N	引張強度/極、最大	7 N

材料データ

絶縁材	LCP GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	はんだ接続の層構造	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn matt
プラグ接点の層構造	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn matt	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	100 °C	温度範囲、設置、最小	-30 °C
温度範囲、設置、最大	100 °C		

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	27.5 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	19 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	24 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	16.5 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	250 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	4 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	4 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3	4 kV		

CSAに準拠した公称データ

定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	18.5 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	18.5 A

作成日 2024/11/05 19:20:07 CET

SL-SMT 5.08HC/02/90G 3.2SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)



証明書番号 (UR)

E60693

定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) 300 V

定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) 18.5 A

承認値への参照

仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) 300 V

定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) 10 A

梱包

ESD レベルのパッケージ	静電気散逸	パッケージ	Tape
VPE 長	329 mm	VPE幅	329 mm
VPEの高さ	42 mm	テープの深さ (T2)	12.8 mm
テープ幅 (W)	32 mm	テープポケットの深さ (K0)	12.3 mm
テープポケットの高さ (A0)	12.3 mm	テープポケット幅 (B0)	13.66 mm
テープポケットの分離 (P1)	16 mm	テープホルルの分離 (E)	1.75 mm
テープポケットの分離 (F)	14.2 mm	テープリール径 (A)	330 mm
表面抵抗	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$		

分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01
ECLASS 14.0	27-46-02-01		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

SL-SMT 5.08HC/02/90G 3.2SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none">• 要求に応じて金メッキの接触面• 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。• はんだアイレットの直径 $D = 1.4 + 0.1 \text{ mm}$• はんだアイレット直径 $D = 1.5 + 0.1 \text{ mm}$、9極から• 図面上の $P =$ ピッチ• 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。• OMNIMATE コネクタは IEC 61984 に準拠した切断容量 (COC) のないコネクタです。指定された使用中、活性化中や負荷がかかっているときにコネクタを抜き差しすることはできません• 平均温度 50°C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	PCN_2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_5.xx_neue_Tapeverpackung_Step_4_DE PCN_2015_208_PL30X_SC-SMT_SL_SMT_3.xx_5.xx_new_Tape_Packaging_Step_4_EN Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel” Produkten
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL DRIVES EN FL DRIVES DE
ホワイトペーパーの表面取り付け技術	Download Whitepaper

作成日 2024/11/05 19:20:07 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.